

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰集成电路有限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集昕”、“士兰集成”、“美卡乐”），均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年2月1日至2023年2月28日，公司为士兰集昕提供担保金额为人民币0.30亿元；为士兰集成提供担保金额为人民币0.60亿元；为美卡乐提供担保金额为人民币0.982亿元。

截至2023年2月28日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为10.74亿元；为士兰集成实际提供的担保余额为6.36亿元；为美卡乐实际提供的担保余额为1.03亿元；担保余额均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保进展情况

2023年2月1日至2023年2月28日，公司在年度预计担保金额内实际发生如下担保：公司于2023年2月7日向招商银行股份有限公司杭州分行出具了《最高额不可撤销担保书》，就美卡乐融资事宜提供连带责任保证担保，担保金额为人民币0.30亿元；公司于2023年2月10日向招商银行股份有限公司杭州分行出具了《不可撤销担保书》，就士兰集昕融资事宜提供连带责任保证担保，担保金额为人民币0.30亿元；公司于2023年2月24日与交通银行股份有限公司杭州东新支行签署了《保证合同》，就士兰集成融资事宜提供连带责任保证担保，担保金额为人民币0.60亿元；公司于2023年2月27日与杭州银行股份有限公司滨江支行签署了《最高额保证合同》，就美卡乐融资事宜提供连带责任保证担保，担保金额为人民币0.682亿元。

截至 2023 年 2 月 28 日,公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 10.74 亿元, 剩余可用担保额度为 2.26 亿元; 为士兰集成实际提供的担保余额为 6.36 亿元, 剩余可用担保额度为 1.64 亿元; 为美卡乐实际提供的担保余额为 1.03 亿元, 剩余可用担保额度为 0.97 亿元; 担保余额均在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

## (二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会, 审议通过了《关于本公司 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》, 同意公司在 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 32 亿元, 其中对士兰集昕担保不超过 13 亿元; 对士兰集成担保不超过 8 亿元; 对美卡乐担保不超过 2 亿元。上述金额包含以前年度延续至 2022 年度的担保余额, 且在 2022 年年度股东大会召开前, 本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告, 公告编号为临 2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。

本次担保在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内, 无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 各公司的基本情况如下:

| 公司名称              | 统一社会信用代码               | 成立时间               | 注册地      | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 股权比例 (%) |       | 主营业务                                              |
|-------------------|------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------|
|                   |                        |                    |          |       |              | 直接       | 间接    |                                                   |
| 杭州士兰集昕<br>微电子有限公司 | 91330101MA<br>27W6YC2A | 2015 年 11<br>月 4 日 | 浙江<br>杭州 | 陈向东   | 224,832.8735 | 36.00    | 32.35 | 8 英寸集成电路<br>芯片、分立器件<br>芯片、半导体、<br>功率模块的制<br>造和销售。 |
| 杭州士兰集成<br>电路有限公司  | 91330101726<br>5863549 | 2001 年 1<br>月 12 日 | 浙江<br>杭州 | 陈向东   | 60,000       | 98.75    |       | 集成电路、半导<br>体、分立器件的<br>制造和销售。                      |
| 杭州美卡乐光<br>电有限公司   | 91330101689<br>094018G | 2009 年 7<br>月 2 日  | 浙江<br>杭州 | 江忠永   | 17,000       | 43.00    | 56.29 | 设计、生产发光<br>二极管。                                   |

(二) 士兰集昕、士兰集成、美卡乐均为本公司的控股子公司。

(三) 截至 2021 年 12 月 31 日，各公司经审计的主要财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

| 公司名称 | 资产总额    | 负债总额    | 净资产     | 营业收入    | 净利润    |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 士兰集昕 | 360,730 | 150,328 | 210,402 | 115,466 | 1,476  |
| 士兰集成 | 197,578 | 96,591  | 100,987 | 165,985 | 11,105 |
| 美卡乐  | 41,557  | 27,025  | 14,532  | 25,522  | 489    |

截至 2022 年 9 月 30 日，各公司未经审计的主要财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

| 公司名称 | 资产总额    | 负债总额    | 净资产     | 营业收入    | 净利润    |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 士兰集昕 | 354,248 | 146,940 | 207,308 | 92,885  | -3,588 |
| 士兰集成 | 204,444 | 94,716  | 109,728 | 136,170 | 7,905  |
| 美卡乐  | 39,950  | 22,907  | 17,043  | 20,432  | 2,530  |

### 三、担保协议的主要内容

| 保证人           | 被担保人          | 债权人              | 担保金额                         | 担保方式     | 担保期限                                                                                                                 | 是否有反担保 | 是否为关联担保 |
|---------------|---------------|------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州美卡乐光电有限公司   | 招商银行股份有限公司杭州分行   | 担保的最高债权额为人民币 0.30 亿元及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 | 自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。                            | 无      | 否       |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州士兰集昕微电子有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州分行   | 担保的债权额为人民币 0.30 亿元及其利息、费用等   | 连带责任保证担保 | 自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。                                                                                    | 无      | 否       |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州士兰集成电路有限公司  | 交通银行股份有限公司杭州东新支行 | 担保的最高债权额为人民币 0.60 亿元及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 | 根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起计至全部主合同项下最后到期的主债务的 | 无      | 否       |

|               |             |                |                             |          |                                                                                         |   |   |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|               |             |                |                             |          | 债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。                                                             |   |   |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州美卡乐光电有限公司 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 | 担保的最高债权额为人民币0.682亿元及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 | 主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。 | 无 | 否 |

#### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

#### 五、董事会意见

公司于2022年3月27日召开的第七届董事会第三十三次会议和2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；公司独立董事就该担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月29日和2022年5月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，公告编号为临2022-017、临2022-023和临2022-033。

#### 六、累计对外担保数量

截止2023年2月28日，公司及控股子公司批准对外担保总额为46.566亿元，占公司最近一期经审计净资产的72.65%。公司对控股子公司提供的担保总额为34.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的55.38%；公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.82%；公司为参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保总额为2.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.45%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日